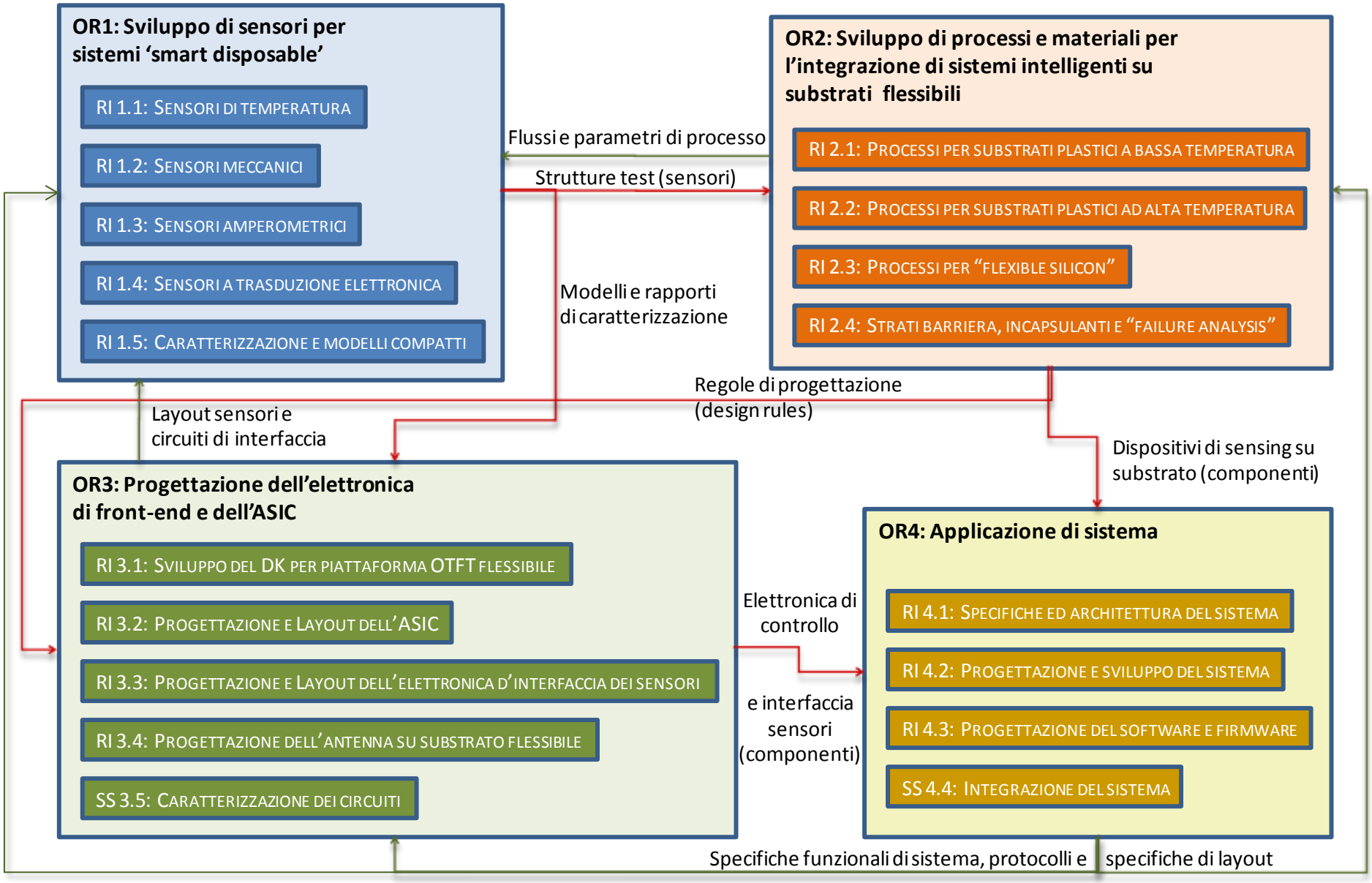
OR1: Sviluppo di sensori per sistemi 'smart disposable'
RI 1.1: Sensori di temperatura
RI 1.2: Sensori meccanici
RI 1.3: Sensori amperometrici
RI 1.4: Sensori a trasduzione elettronica
RI 1.5: Caratterizzazione e modelli compatti
OR2: Sviluppo di processi e materiali per l'integrazione di sistemi intelligenti su substrati flessibili
RI 2.1: Processi per substrati plastici a bassa temperatura
RI 2.2: Processi per substrati plastici ad alta temperatura
RI 2.3: Processi per "flexible silicon"
RI 2.4: Strati barriera, incapsulanti e "failure analysis"
Flussi e parametri di processo
Strutture test (sensori)
Modelli e rapporti di caratterizzazione
Regole di progettazione (design rules)
Layout sensori e circuiti di interfaccia
Dispositivi di sensing su substrato (componenti)
OR3: Progettazione dell'elettronica di front-end e dell'ASIC
RI 3.1: Sviluppo del DK per piattaforma OTFT flessibile
RI 3.2: Progettazione e Layout dell'ASIC
RI 3.3: Progettazione e Layout dell'elettronica d'interfaccia dei sensori
RI 3.4: Progettazione dell'antenna su substrato flessibile
SS 3.5: Caratterizzazione dei circuiti
Elettronica di controllo
e interfaccia sensori (componenti)
OR4: Applicazione di sistema
RI 4.1: Specifiche ed architettura del sistema
RI 4.2: Progettazione e sviluppo del sistema
RI 4.3: Progettazione del software e firmware
SS 4.4: Integrazione del sistema
Specifiche funzionali di sistema, protocolli e specifiche di layout